

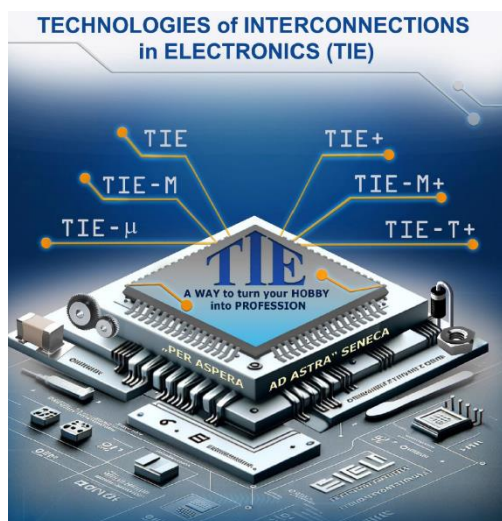
Avem deosebita plăcere să anunțăm că studenții Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, au obținut rezultate remarcabile la prestigiosul [concurs TIE \(Tehnici de Interconectare a Echipamentelor\)](#), ediția 34, desfășurat în România!

🎉 Studenții premiați au demonstrat abilități excepționale, motivație și dedicare în domeniul tehnologiei și ingineriei. Iată numele lor:

- Concursul [TIE E Plus](#): **Octavian-Constantin AXINTE – locul I, Cătălin-Ionut OPRIȚA – locul II.**
- Concursul [TIE T Plus](#): **Daniel Andrei BULUGHEANĂ – locul I, Alexandru Andrei POPOVICI – locul II, Alin TANȚĂU – locul III**
- Concursul [TIE-E](#): **Vlad CRISTESCU – mențiune.** Au mai participat: **Raul HORGOS, Andrei ZĂULEȚ**
- Concursul [TIE Micro](#): **Alexandru-Andrei ALEXA – locul I, Andrei KISS – locul II, Gheorghe Melinte – mențiune.**

👉 Este o realizare deosebită care reflectă nivelul ridicat al educației, munca intensă și pasiunea cultivate în cadrul universității noastre. Felicitări echipelor câștigătoare și coordonatorilor lor: **conf.dr.ing. Liviu VIMAN, conf.dr.ing. Cristian FĂRCAȘ, conf.dr.ing. Mihai DĂRĂBAN, ș.l.dr.ing. Raul FIZEȘAN** — ne-ați făcut mândri!

[Concursul Profesional Studentesc TIE](#) oferă o platformă în care studenții sunt provocați să abordeze problemele din lumea reală din industria electronică, în special în *electronic*



packaging, aspect crucial al proiectării și producției de produse electronice. În acest context, colaborarea dintre mediul academic, responsabil cu educarea și formarea viitorilor ingineri, și industrie, beneficiarul direct al acestor absolvenți, formează un ecosistem performant. Acest parteneriat asigură beneficii reciproce: studenții au acces la locuri de muncă de înaltă calificare, industria recrutează ingineri bine pregătiți, iar personalul academic poate adapta în mod eficient programele de studii pentru a răspunde nevoilor în evoluție ale sectorului. Acest rezultat al colaborării are scopul de a provoca studenții, an de

an, să își dezvolte abilitățile în tehnici diferite CAD pentru **dezvoltarea circuitelor imprimate (PCB)**, simularea circuitelor pentru **Signal Integrity, Power Integrity si Thermal Integrity**, si design-ul **System-in-Package**.

Întregul proces, de la proiectarea unei componente, până la realizarea unui PCB complet, cu numeroase constrângeri și reguli de proiectare, urmat de fișierele necesare pentru fabricație, este pus în valoare pe întreaga durată a concursului. Cei mai buni **studenți** din universitățile românești – și nu numai – sunt invitați în fiecare an să rezolve sarcini dificile dezvoltate în colaborare de industrie și mediul academic. Subiectele concursului sunt actualizate anual pentru a reflecta cele mai recente progrese tehnologice din industrie.

Experți de renume în electronic packaging, din diverse companii, colaborează îndeaproape cu mediul academic. Împreună, au contribuit semnificativ la componentele esențiale ale competiției: elaborarea subiectului și a scalei de evaluare. Prin acest demers, inginerii implicați în organizarea concursului își propun, pe bază voluntară, să ofere studenților de azi sprijinul și oportunitățile pe care le-au avut și ei în anii de facultate.

Unul dintre obiectivele principale ale TIE este **formarea unei comunități solide** dedicate oferirii unei platforme pentru studenți tineri și entuziaști, unde să își poată demonstra abilitățile dobândite prin cursuri, stagii de practică și interese personale.

Un număr tot mai mare de studenți participă la evenimentul **TIE**, datorită numeroaselor beneficii pe care acesta le oferă. Participarea la TIE le permite studenților să își prezinte proiectele în fața experților din industrie și a potențialilor angajatori, îmbunătățindu-și semnificativ perspectivele de carieră prin vizibilitate și oportunități valoroase de networking. În plus, studenții cu rezultate notabile la concursul **TIE-E** primesc certificări valoroase care confirmă competențele lor în proiectarea PCB-urilor – o abilitate esențială în ingineria hardware. Aceste certificări, recunoscute de companii de tehnologie de top, reprezintă un **pașaport pentru oportunități excelente de carieră**.



Toți studenții care participă la concursul profesional TIE sunt selectați de către profesorii lor, în urma **fazelor locale ale concursului**.

În cadrul concursului, fiecare concurent este evaluat de o echipă mixtă formată din membri din industrie și mediul academic, pe baza unei scale de evaluare dezvoltate de **Comitetul Tehnic** în colaborare cu formatorii academici, facilitând astfel o clasificare corectă, clară și transparentă. **TIE** reprezintă **dovada eforturilor comune voluntare** ale mediului academic

și industriei. Această colaborare contribuie la pregătirea unor ingineri de înaltă calitate, adaptați atât nevoilor actuale ale industriei, cât și cerințelor viitoare ale mediului academic.

În timpul evaluării, accentul se pune pe **analiza detaliată a calității și preciziei soluției oferite de către fiecare student**. Procesul de evaluare se bazează pe mai mulți factori critici, fiecare element trebuie să respecte regulile specifice ale concursului.

Dedicarea instituțiilor academice în dezvoltarea unui mediu în care studenții pot explora și inova, alături de sprijinul constant oferit de experții din industrie, care contribuie cu cunoștințe practice și tehnologii de vârf, au ridicat **competiția TIE** la rangul de **provocare studențească națională, recunoscută în industrie**. Acest parteneriat între mediul academic și industrie a creat o oportunitate de dezvoltare excepțională, în care cunoștințele teoretice sunt integrate perfect cu aplicațiile din lumea reală, pregătind **următoarea generație de ingineri** pentru provocările viitorului. Angajamentul pentru excelență și mentorat nu doar că a modelat carierele participanților, dar a și contribuit la avansarea domeniului, stabilind un nou standard pentru colaborările viitoare.

În paralel cu concursul, s-a desfășurat și prima ediție a evenimentului **MICROELECTRONICS DAYS**, organizat de **Grupul de Lucru pentru Microelectronică din cadrul Comisiei STMS a Academiei Române**. În cadrul acestui eveniment, participanții au avut ocazia să asiste la prezentări pe tema **Chiplets și Integrare Eterogenă pentru Companii Inovatoare**, precum și să ia parte la diverse workshop-uri sau întâlniri ad-hoc între participanții direcți și indirecți ai **IPCEI** sau ai altor proiecte colaborative. În aceste zile, participanții au putut asista la prezentările susținute de **Victoria CUMMINGS** – reprezentant ECSA, EU Chips-Skill Academy, **Dr. Peter TRANITZ** – IPC EU Silicon to Systems, **Simion CREȚU** – Director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională ADR Centru, **Ioan LEVITCHI** – Director al Departamentului de Politici Regionale, ADR Centru, **Dr. Andrei AVRAM** – Director Tehnic IMT, precum și **Carolyn TUBILLO** – Cadence, soluții EDA.